

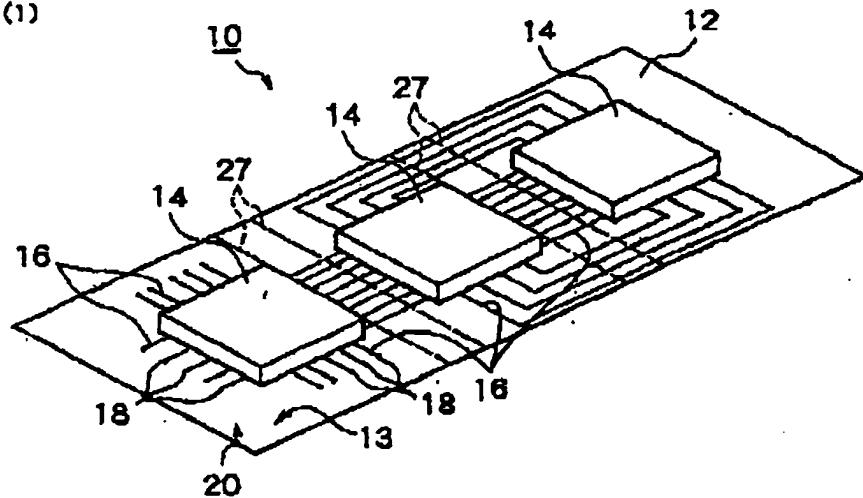
提出日 平成12年 1月12日
頁: 1/ 5

整理番号=J0074549

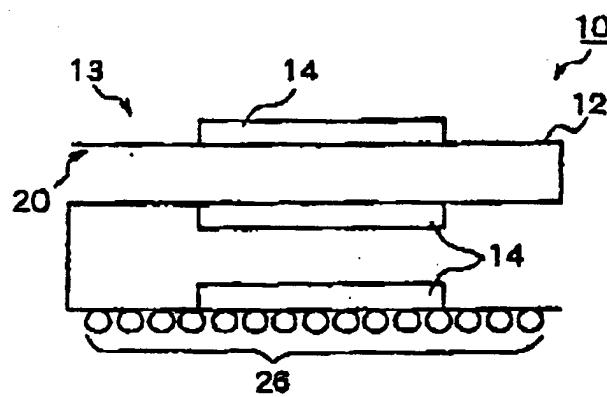
【類名】 図面

【図1】

(1)



(2)



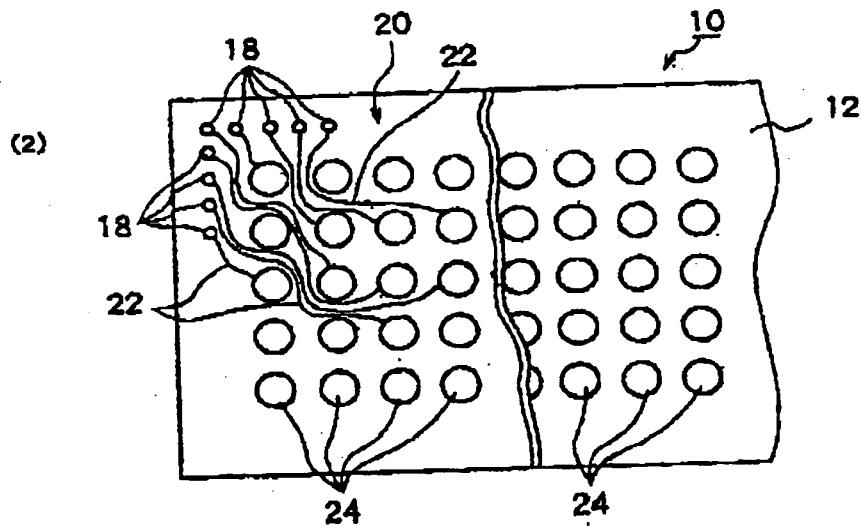
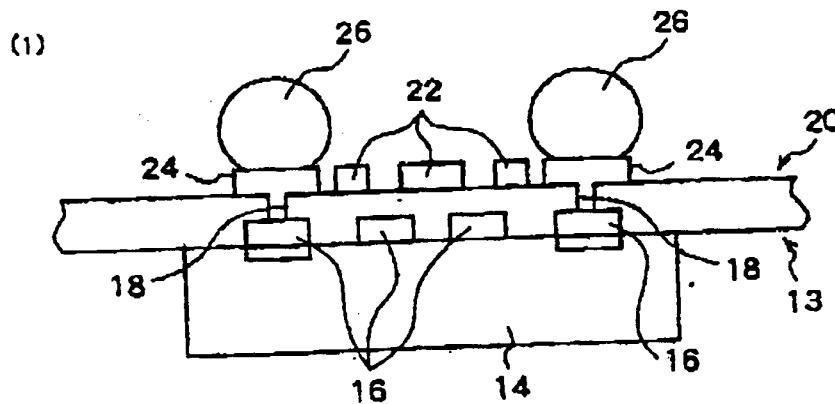
10: SEMICONDUCTOR DEVICE
 12: CONNECTION SUBSTRATE
 14: SEMICONDUCTOR CHIP
 16: 1st METALLIC WIRING

提出日 平成12年 1月 12日

頁: 2/5

整理番号=J 0 0 7 4 5 4 9

【図2】

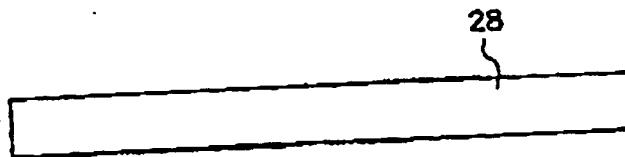


提出日 平成12年 1月12日
頁: 3/5

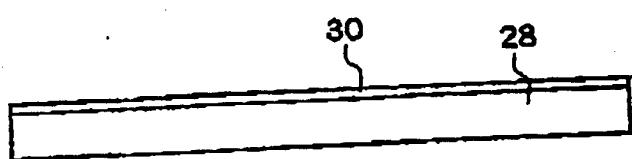
整理番号=J0074549

【図3】

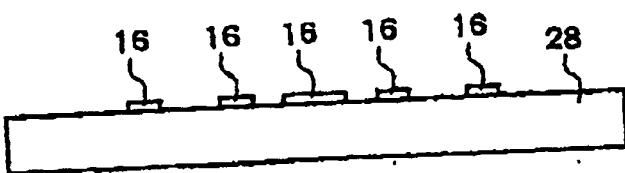
(1)



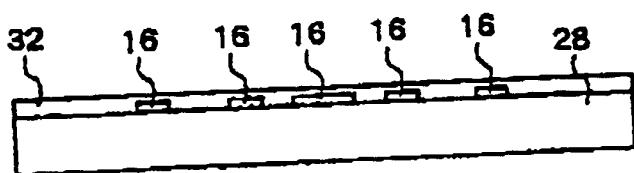
(2)



(3)



(4)



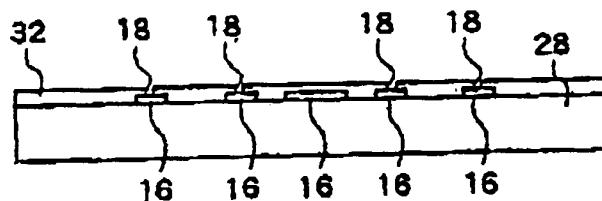
提出日 平成12年 1月12日

頁: 4/5

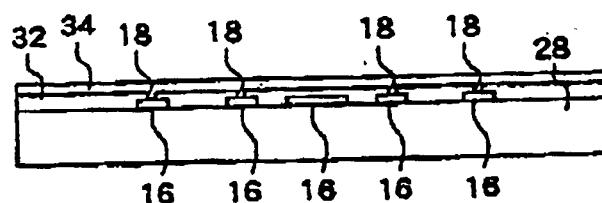
整理番号=J0074549

【図4】

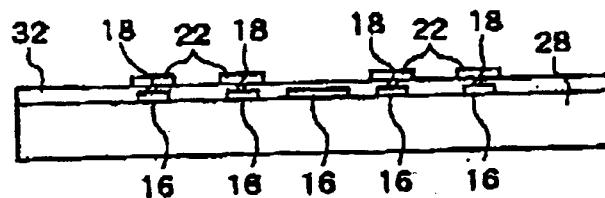
(1)



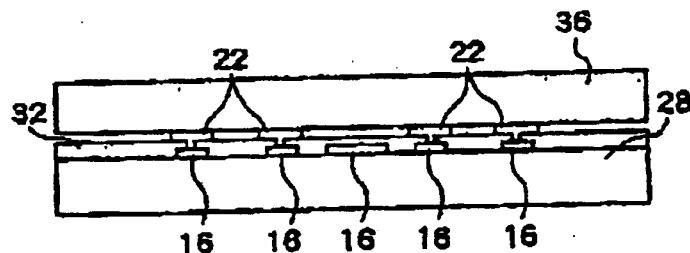
(2)



(3)



(4)



2000年11月20日 16時52分

特許庁

393 P. 26/27

提出日 平成12年 1月12日
頁: 5/6

整理番号=J0074549

【図5】

